

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2022-055

转债代码：113639

转债简称：华正转债

## 浙江华正新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与深圳先进电子材料国际创新研究院（以下简称“电子材料院”）共同出资设立合资公司，开展 CBF 积层绝缘膜（可应用于先进封装领域诸如 FC-BGA 高密度封装基板、芯片再布线介质层、芯片塑封、芯片粘结、芯片凸点底部填充等重要应用场景的关键封装材料）项目相关产品的研发和销售。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-046）。

近日，公司与电子材料院签署了合作投资协议，完成了设立合资公司的相关工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《营业执照》，相关登记信息公告如下：

公司名称：深圳中科华正半导体材料有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HG98043

类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区 1 栋 201

法定代表人：周阳

注册资本：8,000 万元人民币

成立日期：2022 年 08 月 31 日

经营范围：一般经营项目是：半导体器件专用设备销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子专用材料制造。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2022年9月2日